

# 10A Avg. 120 Volts

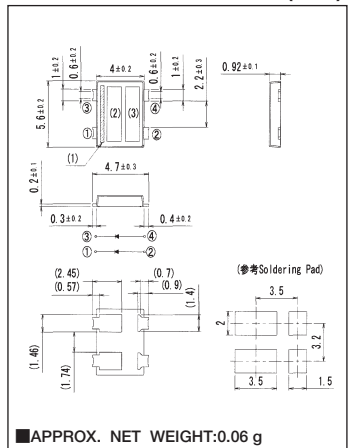
# SBD

# NB10HSA12

## 最大定格 Maximum Ratings

Item	Symbol	Conditions	Unit
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	120	V
平均整流電流 Average Rectified Forward Current	$I_O$	50Hz, 正弦半波通電抵抗負荷 50Hz Half Sine Wave Resistive Load *1	2.7 10 A A
実効順電流 R.M.S. Forward Current	$I_F(RMS)$	11.1	A
サージ順電流 Surge Forward Current	$I_{FSM}$	100 50Hz正弦半波, 1サイクル, 非くり返し 50Hz Half Sine Wave, 1cycle, Non-repetitive	A
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	$T_{jw}$	-40~+150	°C
保存温度範囲 Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-40~+150	°C

## OUTLINE DRAWING(mm)



## 電氣的・熱的特性 Electrical/Thermal Characteristics

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	$I_{RM}$	$T_j=25^\circ\text{C}, V_{RM}=120\text{V}$ , 一素子あたり Per Diode	—	—	100	$\mu\text{A}$
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	$V_{FM}$	$T_j=25^\circ\text{C}, I_{FM}=5\text{A}$ , 一素子あたり Per Diode	—	—	0.86	V
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-a)}$	接合部・周囲間 Junction to Ambient	—	—	60	°C/W
	$R_{th(j-l)}$	接合部・リード間 Junction to Lead	—	—	7	°C/W

\*1 カソードコモン動作による/Common Cathode Operation

\*2 プリント基板実装/Glass-Epoxy Substrate mounted (Soldering Lands= 2.0 × 1.5 mm, 2.0 × 3.5 mm, Both Sides)

## 定格・特性曲線

